

【11】證書號數：M574199

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 02 月 11 日

【51】Int. Cl.： F21S41/147 (2018.01) F21V29/505 (2015.01)

新型

全 3 頁

【54】名稱：封裝注塑式 LED 燈

PACKAGE INJECTION MOLDED LED LAMP

【21】申請案號：107210187

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 07 月 26 日

【72】新型創作人：王濤 (CN)

【71】申請人：王濤

中國大陸

【74】代理人：高宏銘

【57】申請專利範圍

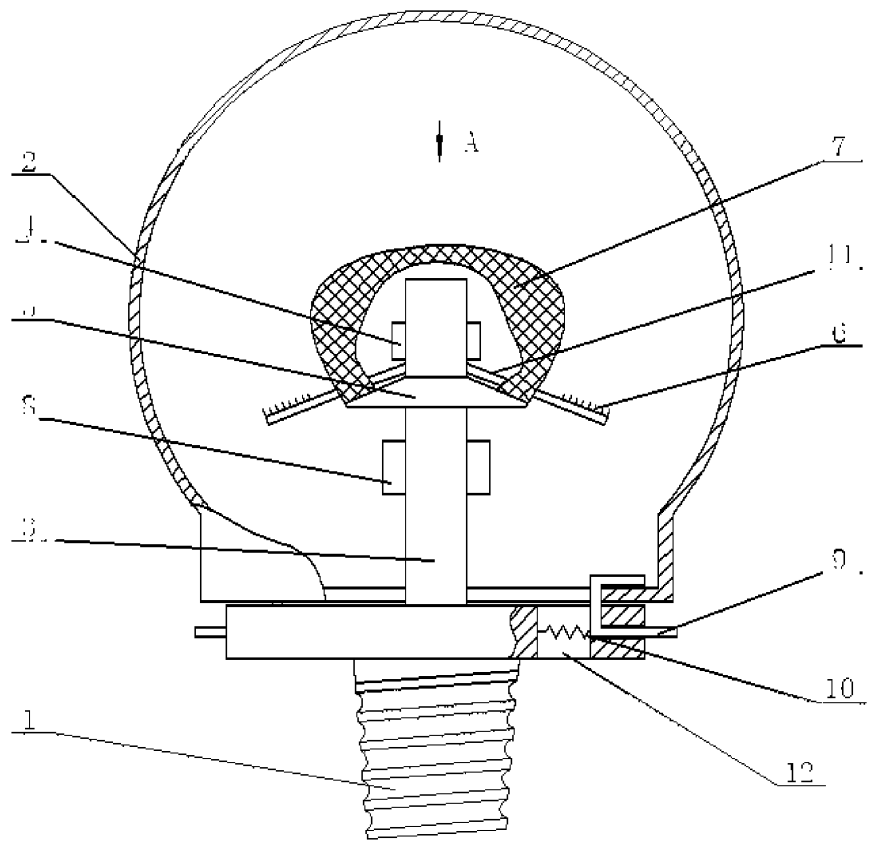
1. 一種封裝注塑式 LED 燈，其特徵在於：包括燈頭(1)和燈罩(2)，燈頭(1)上方安裝基板(3)，燈罩(2)安裝在燈頭(1)上並且罩住基板(3)，基板(3)端部安裝數個 LED 光源(4)，LED 光源(4)下方安裝反光板(5)，反光板(5)上塗有封裝層(7)，封裝層(7)覆蓋反光板(5)的頂部和 LED 光源(4)，基板(3)上安裝數個驅動電子元件(8)，LED 光源(4)連接散熱條(11)，散熱條(11)的端部設有散熱片(6)。
2. 如請求項 1 所述之封裝注塑式 LED 燈，其特徵在於：所述的燈頭(1)上部外周開設數個滑動槽(12)，滑動槽(12)內設有 J 型卡扣(9)，J 型卡扣(9)的一端位於燈頭(1)的外側，滑動槽(12)內安裝彈簧(10)，彈簧(10)與 J 型卡扣(9)連接，彈簧(10)始終給 J 型卡扣(9)一個向外的推力，燈罩(2)的下端設有向內翻折的沿，J 型卡扣(9)的另一端位於燈頭(1)的上部並與燈罩(2)的下部的沿配合。

圖式簡單說明

為了更清楚地說明本新型實施例或現有技術中的技術方案，下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的圖式作一簡單地介紹。顯而易見地，下面描述中的圖式是本新型的一些實施例，對於本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動性的前提下，還可以根據這些圖式獲得其它的圖式。

圖 1 是本新型的結構示意圖；圖 2 是圖 1 的 A 向視圖的放大圖。

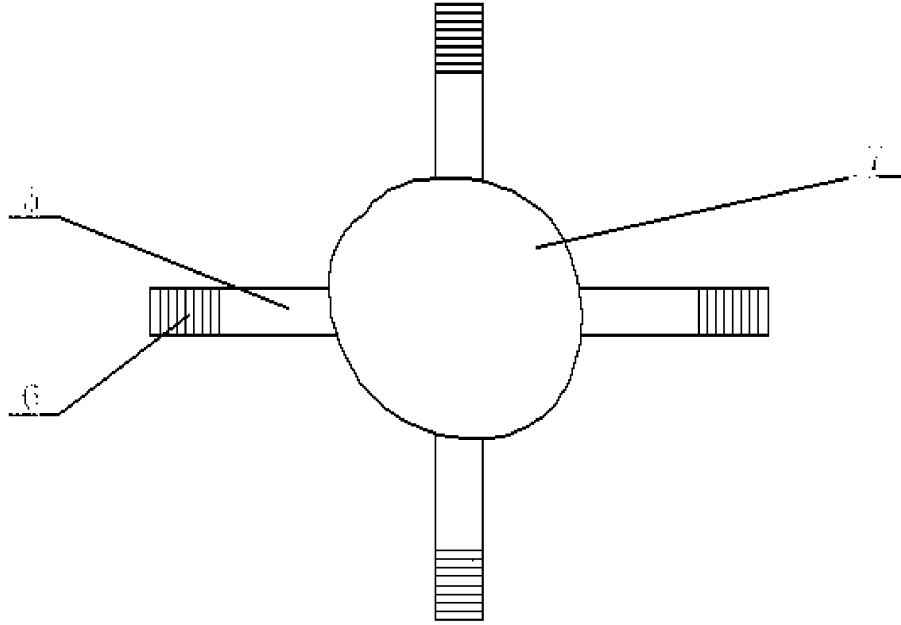
(2)



【圖1】

(3)

A



【圖2】